Temperaturprofilierung

Messmethoden und Wege zum optimalen Reflowlötprofil

8. Februar 2023 in Blaubeuren

Die Welt der elektronischen Baugruppen ist so vielfältig und komplex, dass es nicht möglich sein wird, alle spezifischen Bedürfnisse der Bauelemente und Materialien hinreichend abzubilden. Es bleibt also dem Sachverstand und Geschick des Fertigers überlassen, die optimalen Reflowparameter zu finden. Ausreichende Hinweise, Indizien und Erfahrungen sind jedoch vorhanden, um eine Optimierung zu ermöglichen. Entdecken Sie in unserem Seminar das Machbare vom Mythos zu unterscheiden. Der erste Teil dieses Seminars gibt Ihnen Einblick in die Grundlagen und die optimalen Parameter der Reflowprofilierung. Im zweiten Teil lernen Sie ein Messboard zu präparieren, den Nutzen einer Wärmebildkamera zu verstehen sowie Reflowprofile selbst zu erstellen.

Teilnehmerzahl: max. 20 Personen
Schulungsdauer: 1 Tag
Teilnahmegebühr: 449 p.P. € inkl. Tagungsgetränken, Mittagessen, Schulungsunterlagen

09.15 Uhr	**Begrüßung**
09.30 Uhr	**Grundlagen der Reflowprofilierung** Normen, Messboards und Thermoelemente
10.45 Uhr	**Praxis 1: Erstellung einer Reflow-Hüllkurve**
11.15 Uhr	**Kaffeepause**
11.45 Uhr	**Praxis 2: Messboard-Präparation** (Technology Center)
13.00 Uhr	**Mittagspause**
13.45 Uhr	**Praxis 3: Profilierung an der VisionXP+** (Technology Center)
15.00 Uhr	**Kaffeepause**
15.15 Uhr	**Tipps & Tricks zur Präparation und Profilierung** Einsatz der Wärmebildkamera, Fehler und Toleranzen
15.45 Uhr	**Optimale Profilierung: Mythos oder Wahrheit?** Vorstellung der Messergebnisse
16.30 Uhr	**Ende des Seminars** Zeit für Diskussion, Get-together und Firmenrundgänge

Vorbehaltlich inhaltlicher Anpassungen

TECHNOLOGY ACADEMY

Anmeldungsformular unter
www.rehm-group.com/aktuelles/termine